

# DRY SLICER

## *Stress Free Depaneling Solution* **SAM-CT26USL**



LED 基板切断に最適  
長尺 650mm 基板対応

## 特長 Features

### 低ストレス切断 Low stress cutting.

切削時にプリント基板に与えるストレス(歪)は極小で、安全に切断できます。  
Safe cutting because minimized cutting stress.

歪(参考値): 約 100  $\mu\epsilon$   
[条件: 樹脂基板 (t1.2mm)、GC ブレード (t0.5mm)、切削速度 150mm/sec]  
Strain (Reference data): Approx. 100  $\mu\epsilon$   
[Condition: CEM3(t1.2mm), GC blade(t0.5mm), Cutting speed 150mm/sec]

### V溝不要 V groove free.

V溝なしでの切断が可能です。V溝にかかっていた費用を削減できます。  
Reduce PCB production cost because need no V-groove.

### 長尺基板対応 Capable of cutting long board

Max.650mmの長尺基板対応で、LED基板などの切断に最適です。  
Max board size is 650 mm, it is ideal for cutting LED PCB.

## 仕様

対象基板	最大寸法	L650mm × W250mm t=1.0 ~ 2.0mm
	材質	FR4、FR1、CEM3等
	部品高さ	基板上面 25mm(基板厚み含む)、基板下面 10mm
X軸	モータ種類	サーボモータ(200W) ボールねじ駆動
	切断速度	最大 300mm/sec
	移動速度(戻り)	500mm/sec
Y軸	モータ種類	サーボモータ(200W) ボールねじ駆動
	ワーク送り速度	90mm/sec
	移動速度(戻り)	200mm/sec
Z軸	繰り返し位置決め精度	± 0.03mm
	駆動方式	サーボモータ(100W) ボールねじ駆動
R軸	モータ種類	インバータ駆動式インダクションモータ
	R軸回転数(標準)	6,000rpm(MAX)
刃物	GC 砥石	外径 125mm、内径 40mm、t0.2 ~ 0.5mm(0.5標準)
	基板チップソー	外径 125mm、内径 40mm、t0.5mm
基板保持	基板パレット(治具)	パレット上で位置決め(左中央基準)
	タッチパネル	カラー: 5.7インチ
切断データの作成	入力方法	数値ティーチング
	登録数	300機種
	電源	φ 3 AC200V
本体仕様	最大消費電力	3KVA(集塵機含む)
	エア供給圧	0.4 ~ 0.5Mpa(無給油)
	エア消費量	約 300 $\ell$ / min.
	本体サイズ	W1,450 × D1,200 × H1,450
	本体重量	約 900kg
集塵機	型式	VNA-30
	出力	1,500W
	電源・電圧	φ 3 200V 50Hz / 60Hz 選択

### 切削切断 Nice and smooth finish.

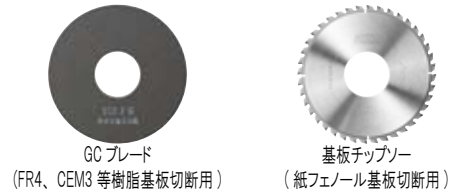
GC ブレードにてガラエポ等の樹脂基板を、基板チップソーにて紙フェノール基板を切削切断します。シャープな切断面は驚きです。  
ツインブレードも使用可能です。

Use grinding stone to cut FR4 etc., and tip saw to cut paper phenol PCB. Nice and smooth finish for PCB cross section.  
Twin-blade can be used.

### 高速切断 High-speed cutting.

基板チップソーによる紙フェノールの基板切断では、最大 300mm/secの高速切断を実現しました。

Max.300mm/s cutting speed for paper phenol PCB when you using tip saw.



GC ブレード  
(FR4、CEM3等樹脂基板切断用)

基板チップソー  
(紙フェノール基板切断用)

## Specifications

PCB	Max.Size	L650mm × W250mm t=1.0-2.0mm
	Material	FR4、FR1、CEM3 etc.
	Component Height Limit	25mm upper surface(incl. PCB thickness), 10mm lower surface
X axis	Type of Motor	Servo motor(200W) Ball screw drive system
	Cutting Speed	Max.300mm/sec
	Moving Speed	500mm/sec
Y axis	Type of Motor	Servo motor(200W) Ball screw drive system
	Feed Rate	90mm/sec
	Moving Speed	200mm/sec
Z axis	Repeatability	± 0.03mm
	Drive System	Servo motor(100W) Ball screw drive system
R axis	Type of Motor	Inverter driving induction motor
	R axis Rotational Frequency(STD)	6,000rpm(MAX)
Blade	GC Wheel	OD=125mm、ID=40mm、t0.2 ~ 0.5mm(STD0.5mm)
	Tip Saw	OD=125mm、ID=40mm、t0.5mm
Holding	Pallet(JIG)	Positioning on Pallet
Teaching	Operation Panel	Touch paner(color)
	Data input	Date teaching
	Number of Data registration	300
Equipment	Electricity	φ 3 AC200V
	Max. Power consumption	3KVA(dust collector is count outed)
	Air Pressure	0.4 ~ 0.5Mpa(need no lubrication)
	Air Consumption	Approx.300 $\ell$ / min.
	Dimension	W1,450 × D1,200 × H1,450
Dust Collector	Net Weight	Approx.900kg
	Type	VNA-30
	Output	1,500W
PowerVoltage	φ 3 200V Select 50Hz or 60Hz	

代理店

**SAYAKA**  
信頼のパートナー

株式会社サヤカ

〒143-0002  
東京都大田区城南島 2丁目3番地3号  
TEL:03(3790)8911  
FAX:03(3790)8917  
URL:http://www.sayaka.co.jp